

БТО ТМ 200-01

Установка быстрого термического отжига для обработки полупроводниковых пластин в инертной среде с целью отжига дефектов и активации примесей после ионного легирования



Технологические характеристики:

Возможность модификаций установок по требованию заказчика.

- Диаметр обрабатываемых пластин - до 200 мм;
- Шлюзовая система загрузки;
- Транспортная система переноса пластин на основе манипулятора;
- Многозонный ИК-нагрев пластин до температуры 1200°C;
- Измерение температуры нагрева пластины с помощью двух пирометров;
- Максимальная скорость нагрева, не менее 100°C/с;
- Скорость охлаждения от +1200°C до +700°C, не менее 35°C/с;
- Скорость охлаждения от +700°C до +200°C, не менее 35°C/мин;
- Узел вращения пластины для повышения равномерности;
- Форвакуумная откачка в случае использования вакуума;
- Количество газовых линий – 3;
- Используемые газы: N₂, O₂;
- Рабочая камера охлаждается до +16°C...+25°C;
- Потребляемая мощность – не более 55 кВт;
- Микропроцессорная система управления;
- Возможность встраивания в «чистую комнату»;
- Возможность быть в составе кластера.

